

# モリリン東日本橋ビル

No. 19-002-2010更新  
改修・保存  
事務所

発注者	モリリン(株)	カテゴリー				
設計・監理	(株)間組一級建築士事務所	A. 環境配慮デザイン	B. 省エネ・省CO2技術	C. 各種制度活用	D. 評価技術/FB	
施工	(株)間組東京建築第一支店	E. リニューアル	F. 長寿命化	G. 建物基本性能確保	H. 生産・施工との連携	
		I. 周辺・地域への配慮	J. 生物多様性	K. その他		

## 壊さないで建物を一新したオフィスビル

東京都中央区東日本橋は古くからの繊維問屋街です。その一角にある創業340年を誇る繊維専門商社東京支店ビルの増改築計画を紹介します。

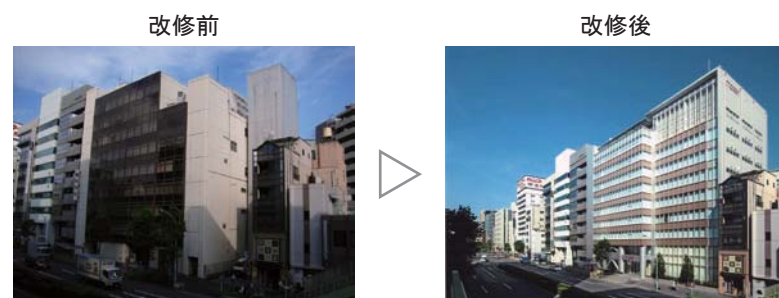
本計画は地震災害に対する耐震性能の向上、施設老朽化に伴う維持費用の低減、事業拡大に伴う拠点機能強化、社員労働環境の整備を目的として、東京社屋に一部増築、及び既存建物の耐震補強を行なうものです。隣接地の取得に伴い全面建替えの検討もありましたが、なにより「古いものでも大切に使いたい」という企業ポリシーとストックの有効活用、CO2・産業廃棄物排出の削減等の理由から、一部増築と改修の選択がなされました。

### 耐震補強（ストックの有効活用）

昭和37年完成の社屋は矩体の劣化が激しく、解体することとしました。次ぐ昭和47年増築部分は耐震診断のうえ耐震補強し、引き続き利用する計画としました。既存の建物で耐震改修できるものはできるだけ利用する方向です。建築年度のことなる2つの既存建物は構造的に別棟であるため、解体における構造性能に変化はありません。さらに新規取得した隣地に増築し、各フロアが一体利用できるようにしました。

### 地区計画との整合性

計画地は道路境界から1m以上の壁面後退が定められた地区計画区域です。耐震改修を行なう昭和47年増築部分は道路境界から0.6mの位置に柱があるため、壁面後退が不可能な構造でした。区と協議の結果、既存耐震補強を行ないながら全面道路側をピロティ化し、公開空地的スペースを確保すること、また増築部分では2.5m後退し近隣に配慮すること等で建築許可をいただきました。また、カーテンウォールを全面更新、増改築でありながら一体的で明るいイメージの建物とすることで街並みに配慮した計画としました。



建物データ	
所在地	東京都中央区
竣工年	2009年
敷地面積	953㎡
延床面積	7,042㎡
構造	増築部 S造・既存改修部 RC造
階数	地下1階、地上10階

### オープンスペースと前面道路側緑化

既存建物の全面的壁面後退は困難でしたが、特に歩行者の視線、圧迫感を軽減するため、既存建物を耐震補強した上で、1階、2階吹き抜けのピロティを設置しました。増築部分は道路境界から2.6m壁面後退しています。前面道路約33mに面して歩行者が自由に出入できるオープンスペースを確保しました。既存建物では敷地内に緑地はありませんでしたが、今回の建設に伴い緑地を積極的に確保しています。増築部分西側では約2.6m壁面後退した部分を緑化し、既存部分西側では約0.5mの緑地帯を設けました。

### 屋上庭園

既存棟屋上の設備機器を移設し、余剰スペースを屋上庭園として整備しました。最上階吹き抜の食堂に隣接し、職員の憩いの場として利用されています。

### 食堂

従業者の職場環境改善の為、もっとも眺望のよい最上部を吹き抜けの職員食堂としました。食堂とはいえランチタイム以外はラウンジ、打合せコーナーとして利用いただいています。

### ショールーム

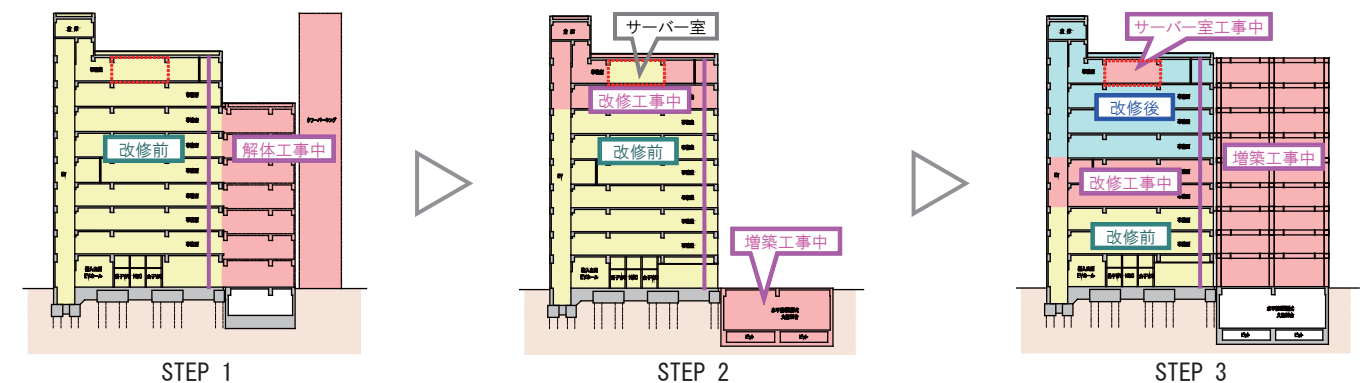
増築部分の1階、エントランス横には2層吹き抜けの多目的ショールームを設置しました。自社製品の展示会や商談、会議など臨機応変な空間として利用いただけます。

### 設備機器の更新

老朽化した設備機器を省エネタイプの機器に更新しました。照明は高効率照明、人感センサー、昼光利用を採用しました。

### 居ながら改修

改修計画で特長となったのは、既存棟で事業を続けながらの「居ながら改修」としたことです。9階から2階までを上から2層分毎に改修して、上下階で引越するというプロセスを繰り返しました。館内での引越し回数が多く利用者にはご迷惑をおかけしましたが、全館移転を行なわないことで、コスト削減、CO2削減に貢献しました。



### 主要な採用技術 (CASBEE準拠)

- Q3.2 まちなみ・景観への配慮 (増築部2.5m外壁後退し、沿路緑化、近隣に配慮)
- LR1.3 設備システムの高効率化 (昼光利用、高効率照明、人感センサー)
- LR2.2 非再生性資源の使用量削減 (全面建替えではなく、既存建物を耐震補強で温存し、一部増築することを選択)
- LR2.3 汚染物質含有材料の使用回避 (PCB処理)

